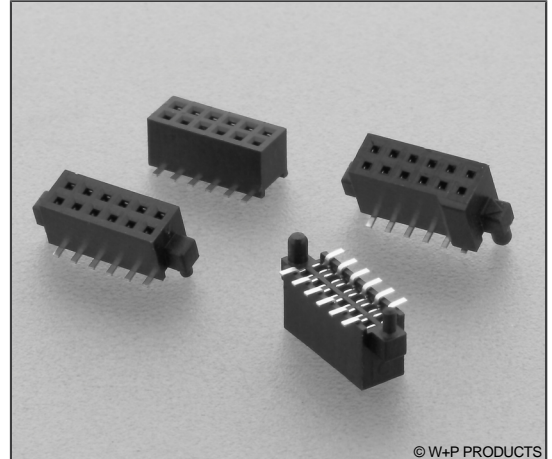


SMT-Buchsenleisten RM 1,27mm, stehend, 2-reihig – BH 3,6/4,5mm, durchsteckbar SMT Female Headers, 1.27mm Pitch, Vertical, Double Row – 3.6/4.5mm Profile, Pass Through

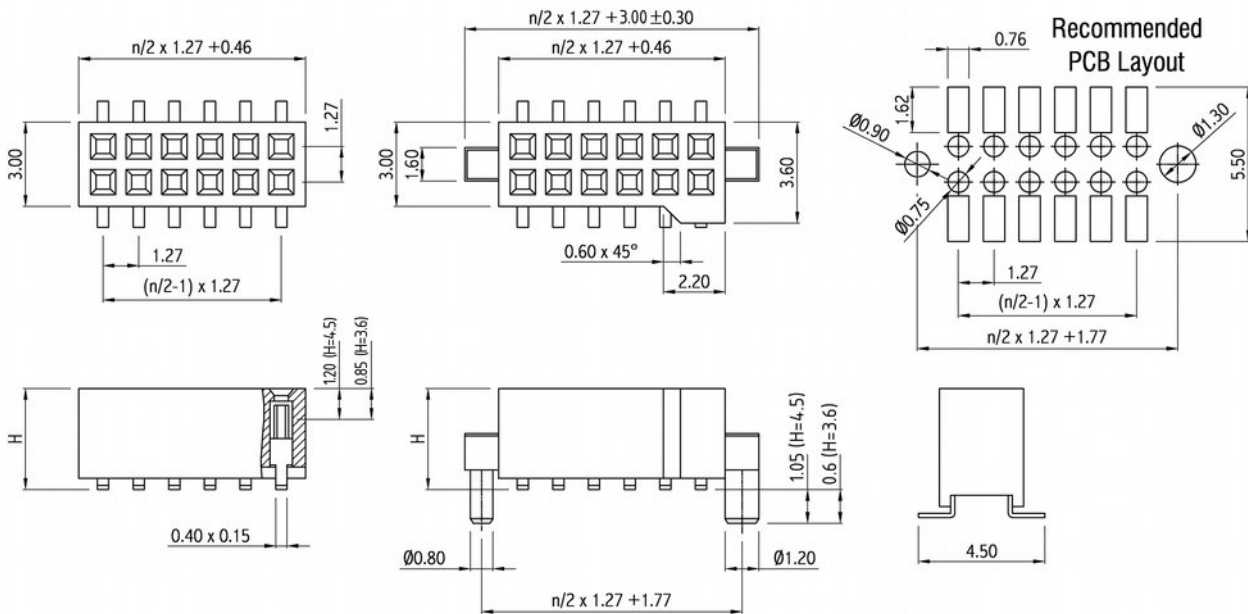
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +125 °C
Temperature Range	-40 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für Vierkantstifte 0,40mm.
Dual beam contacts accept 0.40mm square pins.
Passende Wannestifteleisten:
Compatible Box Headers:
6110 6111



Series	Contacts*	Profile*	Plating*	Locating Pegs*	Polarisation Key*	Packaging*
6060	040	46	00	10	10	PPST
	006-080 Zweireihig Double row	36 Bauhöhe 3,60mm Height 3.60mm 46 Bauhöhe 4,50mm Height 4.50mm	00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated	00 Ohne Pos.hilfen W/o loc. pegs 10 Mit Pos.hilfen With loc. pegs	00 Ohne Verpolschutz W/o pol. key 10 Mit Verpolschutz With pol. key	ST PPST PPTR

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads
PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads
PPTR Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

